

第68期決算説明会

(2020/4/1～2021/3/31)



タカノ株式会社

2021年6月3日

2021年3月期実績および 2022年3月期見込みについて

**2021年3月期決算（連結）
実績の内容について**

●当社および連結子会社の概要について

会社名	沿革等	事業の内容
※当社 タカノ株式会社	1953年7月 ばね製造会社として設立 平成9年東証上場	・ オフィス家具、ユニット（ばね）製品、エクステリア製品、 画像処理検査装置、電磁アクチュエータ、健康福祉関連機器 の製造販売
※連結子会社 (株)ニッコー [機械・工具]	1968年3月 グループ内の工具機械等の仕入を する商社機能として設立	・ 工具、器具、機械、エクステリア製品の仕入販売
※連結子会社 タカノ機械(株) [検査計測機器]	1979年9月 当社治工具・専用機の設計製造 部門を分離独立させ設立。	・ 省力化機械の製造販売 ・ 検査計測装置のメカ機械等の製作
※連結子会社 台湾鷹野股份有限公司 [検査計測機器]	2005年2月 当社100%子会社として設立、 同年4月より営業を開始	・ 台湾におけるFPD向け画像処理検査装置のメンテナンス、ア フターサービス、販売活動
※連結子会社 上海鷹野商貿有限公司 [住生活関連機器]	2010年2月 当社100%子会社として設立 2013年12月 資本金を50万米ドルに増資	・ オフィス家具他、各種製品の仕入販売 （当社各部門の中国市場向けの製品の販売活動等、中国から の部材仕入れ活動等を行う目的で設立）
※連結子会社 香港鷹野國際有限公司 [産業機器]	2011年8月 当社100%子会社として設立（登記） 2012年4月（営業本格開始）	・ 産業機器（電磁アクチュエータ）製品、検査計測機器製品お よびそれぞれの製品にかかる部品等の仕入・販売（輸出入）
※連結子会社 Takano of America Inc. [産業機器]	2019年8月 当社100%子会社として設立（登記） 2020年4月（営業本格開始）	・ 産業機器（電磁アクチュエータ）製品の仕入・販売

●2021年3月期連結決算実績（対前期比）

	2021年3月 (百万円)	2020年3月 (百万円)	前年同期比 (%)
売上高	20,050	22,346	89.7%
営業利益	△97	754	—%
経常利益	147	858	17.2%
親会社株主に帰属 する当期純利益	△11	585	—%

●2021年3月期連結決算実績（対予想比）

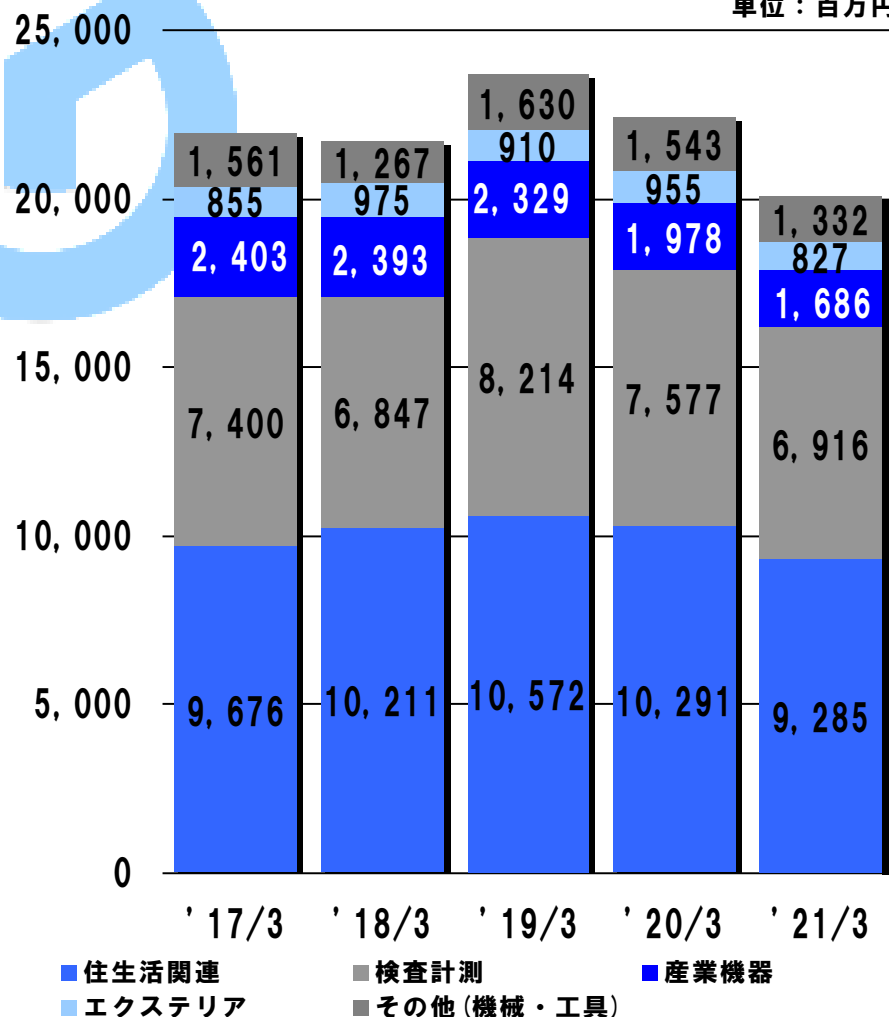
	2021年3月実績 (百万円)	2021年3月予想 (百万円)	予想比 (%)
売上高	20,050	19,300	103.9%
営業利益	△97	△130	—%
経常利益	147	90	163.9%
親会社株主に帰属 する当期純利益	△11	100	—%

※予想値は、2020年11月6日に開示しました業績予想値を採用しております。

●セグメント別売上高の推移

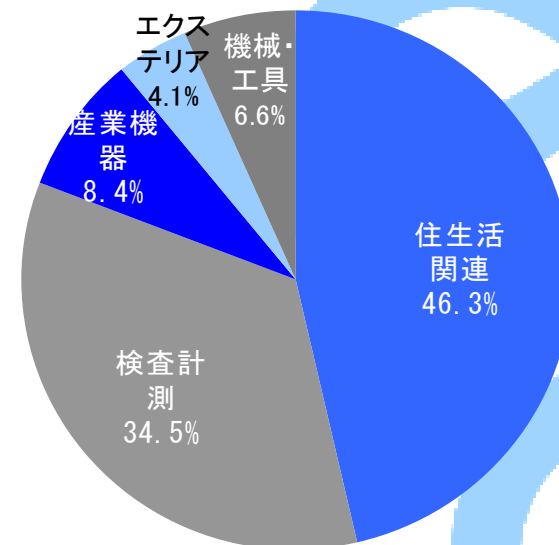
セグメント別売上高の推移

単位：百万円



	2021/3 (百万円)	2020/3 (百万円)	前年 同期比
住生活関連	9,285	10,291	90.2%
検査計測	6,916	7,577	91.3%
産業機器	1,686	1,978	85.2%
エクステリア	827	955	86.7%
その他(機械・工具)	1,332	1,543	86.3%
合計	20,050	22,346	89.7%

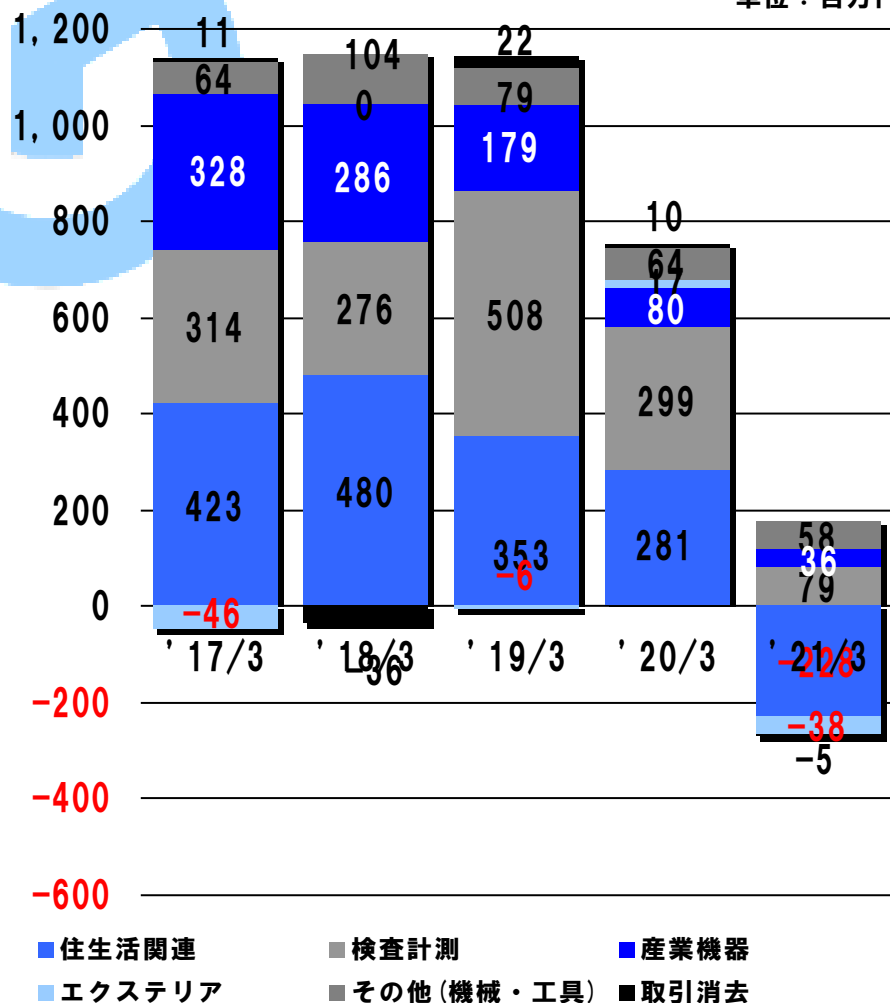
2020/3連結売上高構成比



●セグメント利益の推移

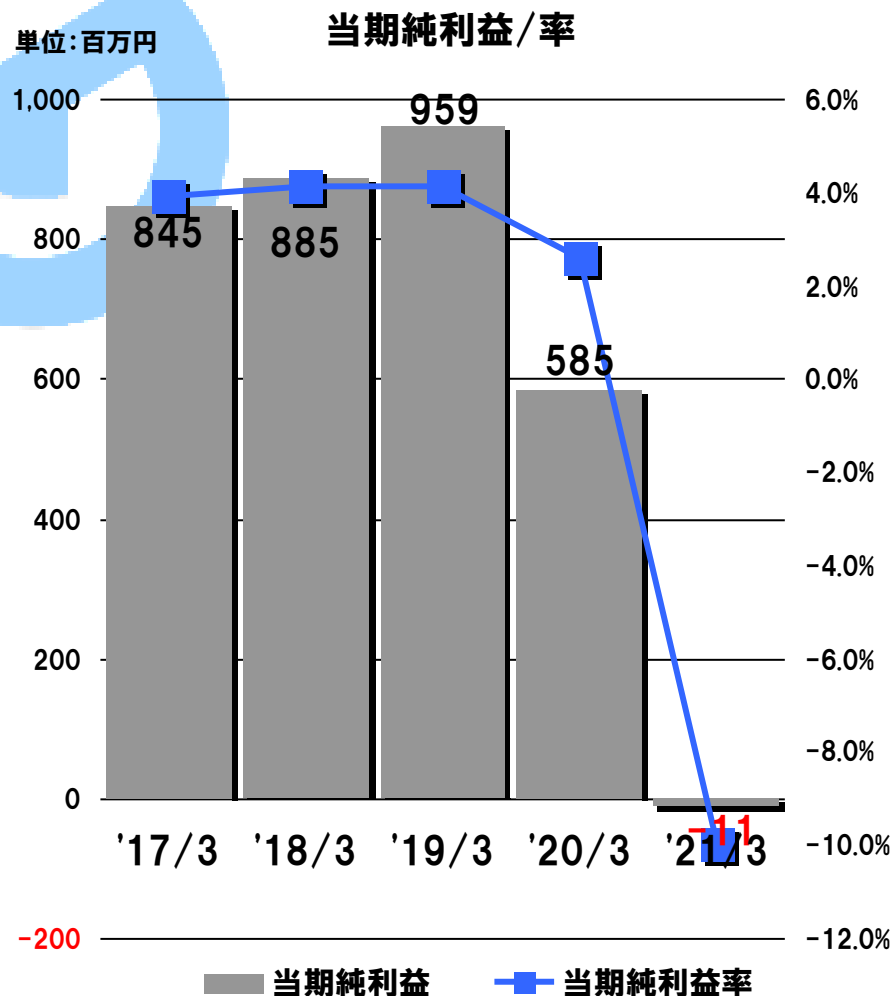
セグメント利益の推移

単位：百万円



	2021/3 (百万円)	2020/3 (百万円)	前年 同期比
住生活関連	△228	281	—%
検査計測	79	299	26.4%
産業機器	36	80	45.5%
エクステリア	△38	17	—%
その他（機械・工具）	58	64	91.2%
取引消去	△5	10	—%
合計	△97	754	—%

●当期純利益の推移(連結)



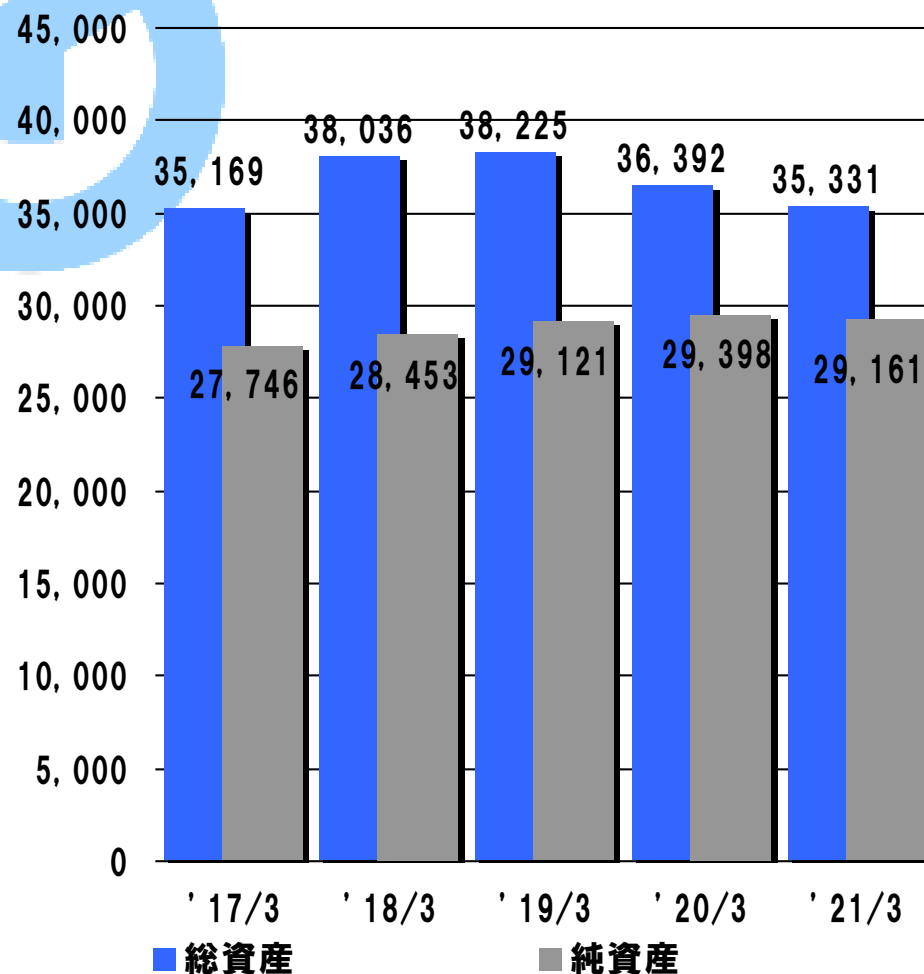
○2021年3月期の1株当たり純損益
△0円75銭

※会計基準の変更により、2016年3月期より、当期純損益の表示が「親会社株主に帰属する当期純利益」となっておりますが、便宜上2016年3月期以降は従前どおりの科目表示としております。

●総資産・純資産の推移（連結）

総資産/純資産

単位：百万円



○2021年3月期の自己資本比率 82.5%

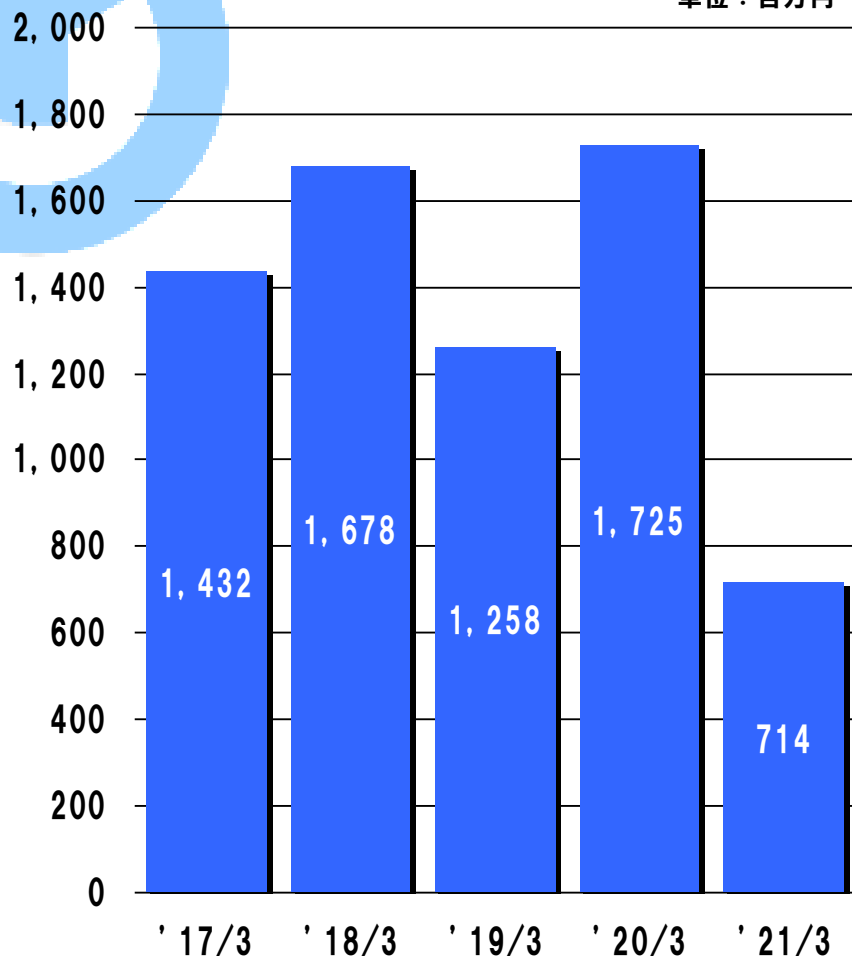
○2021年3月期の自己資本利益率 △0.0%

○2021年3月期末の1株当たり純資産
1,918円97銭

● 主な設備投資内容・設備投資額推移

設備投資額推移

単位：百万円



※設備投資額は有形＋無形固定資産の設備投資に係るものであります。

	2021/3 (百万円)	2020/3 (百万円)	前年 同期比
住生活関連	423	1,035	40.9%
検査計測	158	399	39.7%
産業機器	92	215	43.1%
エクステリア	42	71	59.4%
その他(機械・工具)	11	7	145.7%
調整額	△13	△3	—%
合計	714	1,725	41.4%

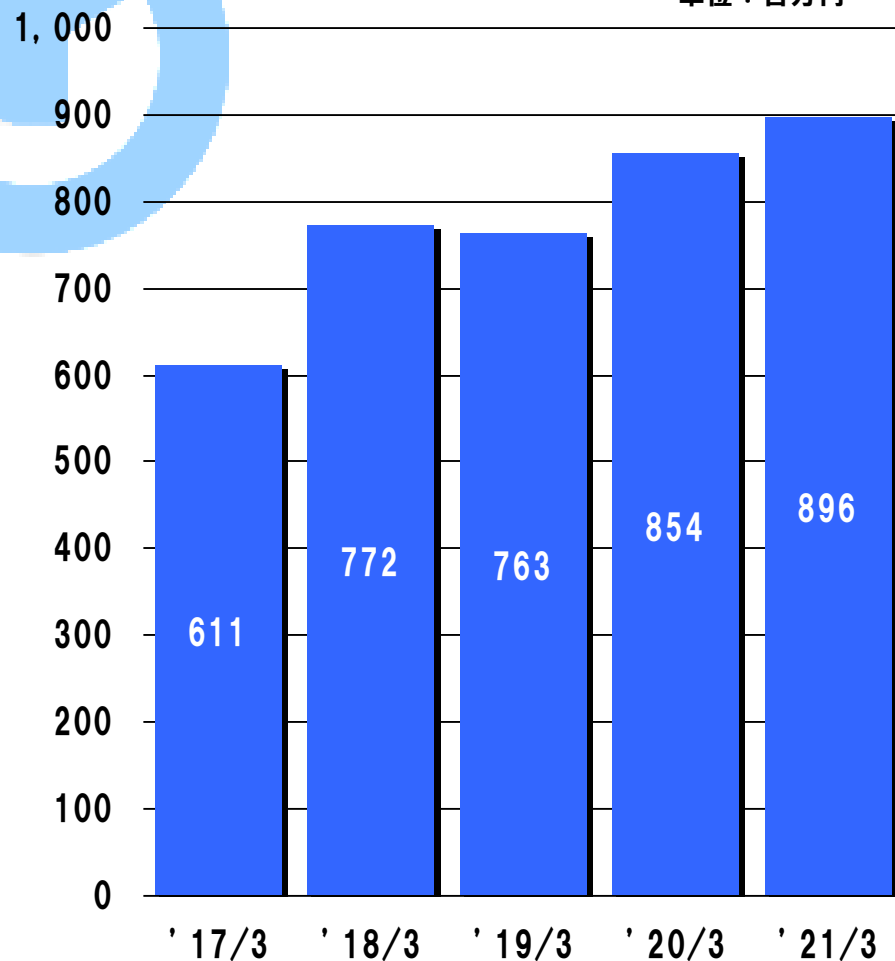
● 当期の主な設備投資の内容

- 住生活関連機器
 - ・ レーザー切断加工機
- 検査計測機器
 - ・ 画像検査装置デモ機製作
- 産業機器
 - ・ ばね自動化装置

● 主な研究開発内容・研究開発費推移

研究開発費推移

単位：百万円



	2021/3 (百万円)	2020/3 (百万円)	前年 同期比
住生活関連	109	108	100.5%
検査計測	695	667	104.2%
産業機器	26	0	—%
エクステリア	0	0	—%
基礎研究(区分不能)	65	78	84.0%
合計	896	854	104.9%

● 当期の主な研究開発の内容

■ 住生活関連機器

- ・ 新素材研究等

■ 検査計測機器

- ・ 高速・高分解能新型カメラおよび画像処理装置開発他
- ・ 半導体向け高速新検査装置開発

■ 新事業開発関係（基礎研究）

- ・ 体外診断用医薬品および診断装置開発
- ・ 医療関連機器開発

●2021年3月期連結キャッシュフロー計算書

	2021年3月 (百万円)	2020年3月 (百万円)	前年比増減 (百万円)	備考
営業活動によるCF	1,526	724	801	
投資活動によるCF	△731	△1,779	1,047	
財務活動によるCF	△394	△424	29	
現金等換算差額	1	△13	15	
現金等の増減額	401	△1,492	1,893	
現金等期首残高	7,348	8,840	△1,492	
現金等期末残高	7,749	7,348	401	

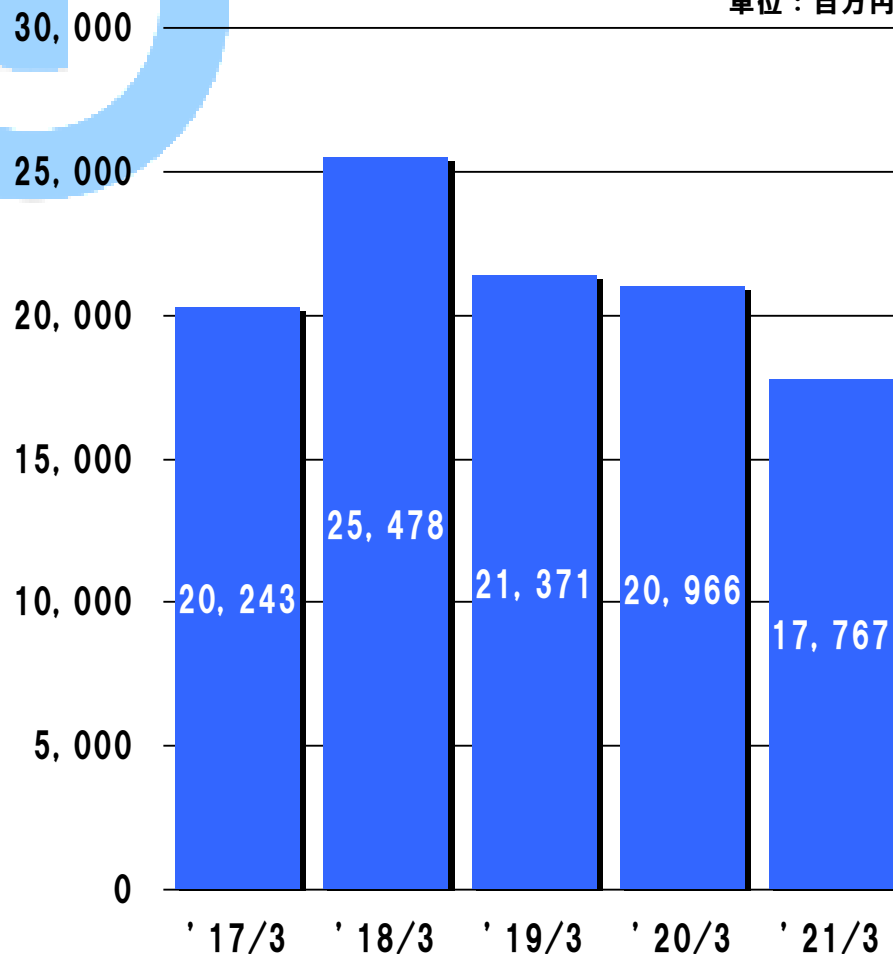
●受注高・受注残高の状況

■検査計測機器事業の受注残高

2021年3月末 3,405百万円(前期末比42.4%減)

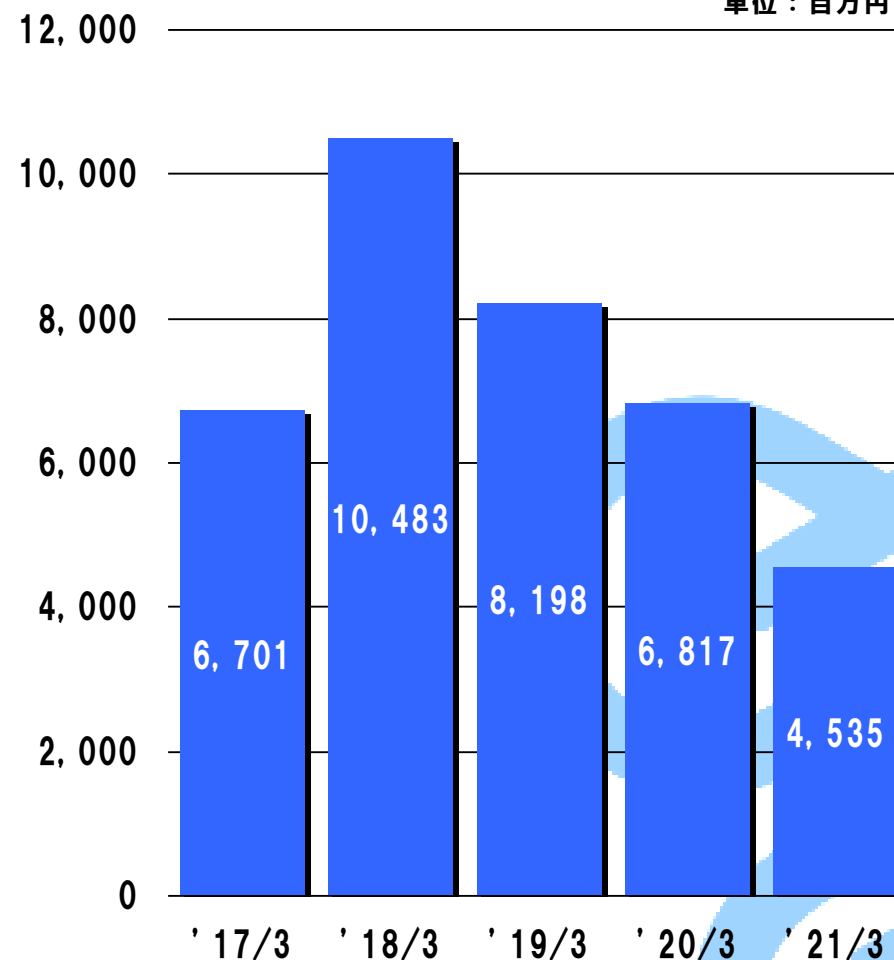
受注高の推移

単位：百万円



期末受注残高推移

単位：百万円

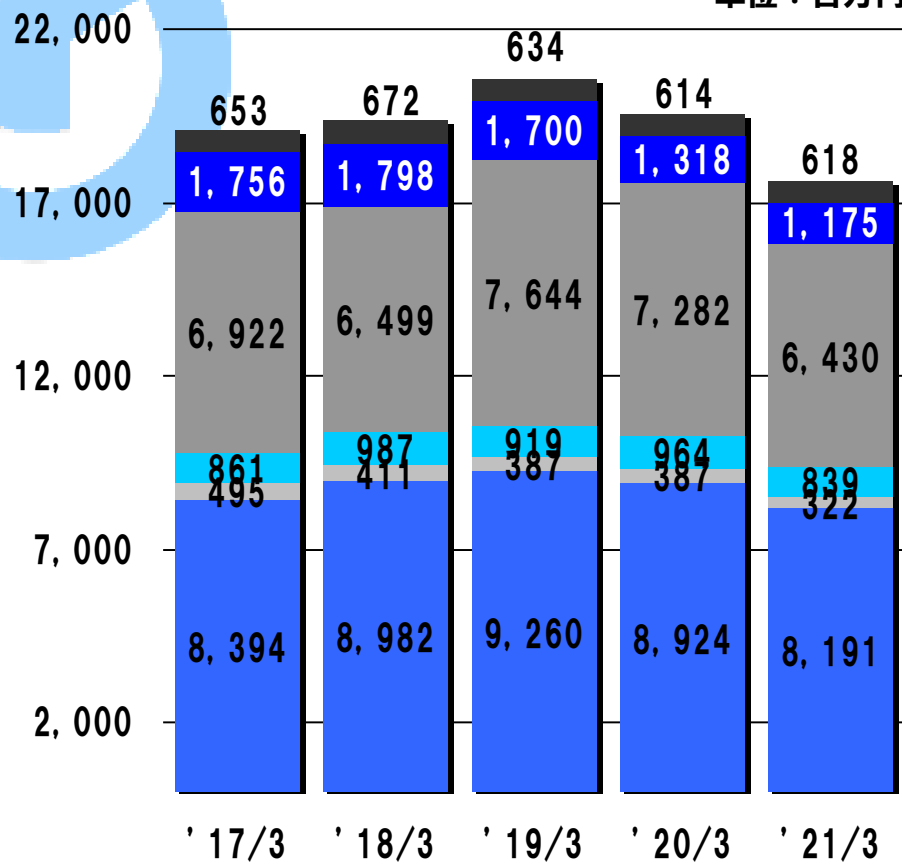


**2021年3月期決算（単独）
部門別売上高実績の内容について**

●部門別売上高（単独）の推移

部門別売上高推移

単位：百万円

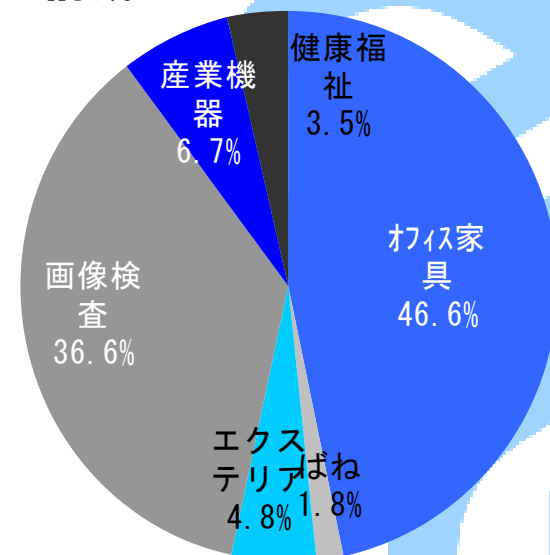


-3,000

■ オフィス家具 ■ 画像検査 ■ エクステリア
■ 産業機器 ■ 健康福祉 ■

	2021/3 (百万円)	2020/3 (百万円)	前年 同期比
オフィス家具	8,191	8,924	91.9%
ばね	322	387	83.3%
エクステリア	839	964	87.1%
画像検査	6,430	7,282	88.3%
産業機器	1,175	1,318	89.2%
健康福祉	618	614	100.7%

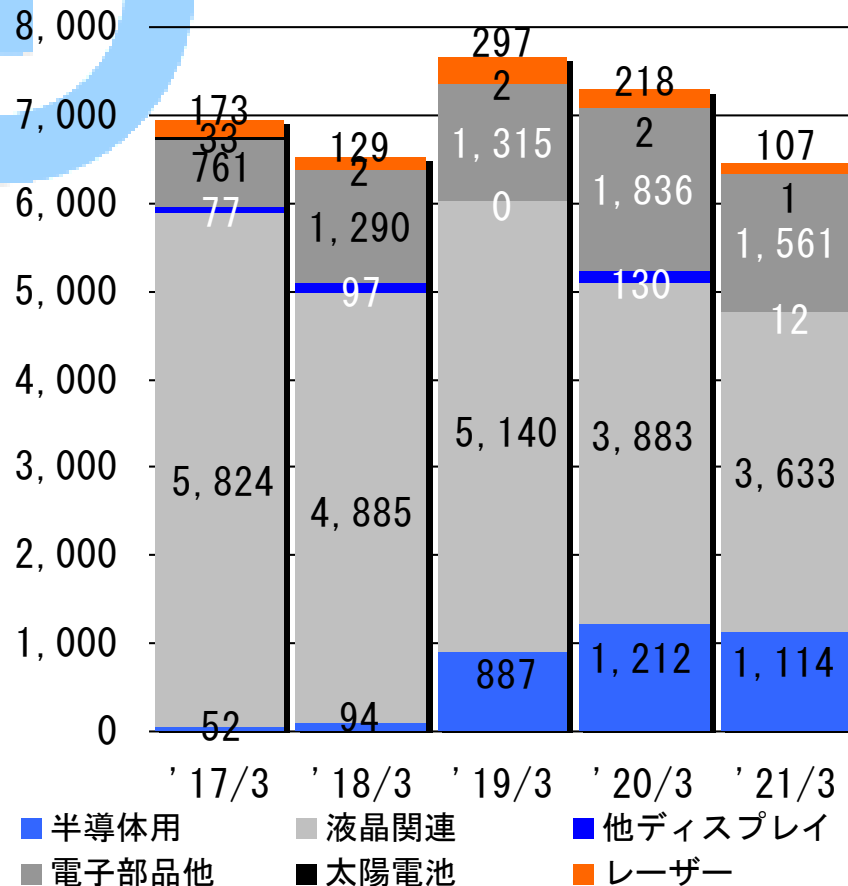
2021/3売上構成比



●検査計測装置売上高の推移

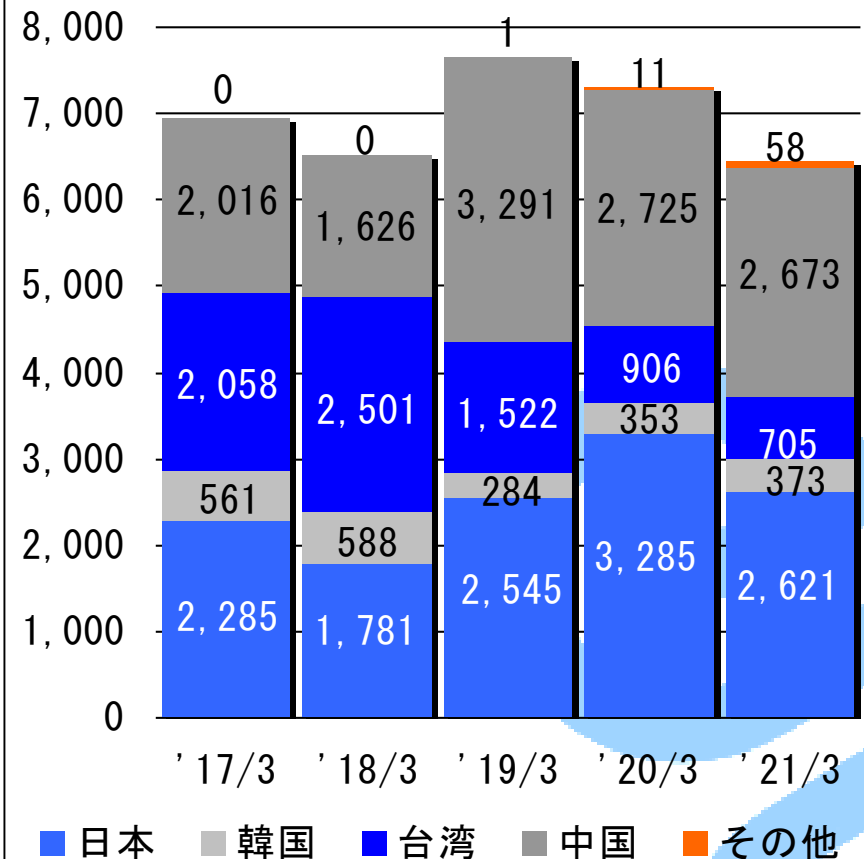
検査計測装置品目別売上高推移

単位：百万円



検査計測装置地域別売上高推移

単位：百万円



2022年3月期決算（連結）の見通しについて

●2022年3月期決算（連結）見通し

	2022年3月予想 (百万円)	前年同期比 (%)	2021年3月実績 (百万円)
売上高	21,810	8.8	20,050
営業利益	445	—	△97
経常利益	500	238.9	147
親会社株主に帰属 する当期純利益	280	—	△11



中期経営計画の 見直し策定について

代表取締役社長 鷹野 準

■中期経営計画の見直しについて

- ・**現行の中期経営計画「Next Innovation 71」は2019年11月に策定公表し、実施を行っている。**
- ・**しかし、その後新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、以下の前提条件に大きな変化が生じたため中期経営計画を見直し策定した。**

■検討すべき前提条件の変化の主たるもの

- **世の中の意識・マーケットの大きな変化(プラス面＋マイナス面)**
- **足元業績と目標との大きな乖離。**

■中期経営計画（ONE TAKANO）の基本方針

スローガン：「ONE TAKANO」
～総合力を発揮する～

基本方針：「構造改革とプロセス改革を進め、
稼ぐ力を取り戻し、次の成長路線
を構築する。」

キーワード： Change
Chance + Speed (Quick Response)
Challenge

■中期経営目標について

【ONE TAKANO】

2024年3月期経営目標値

連結売上高	26,300百万円
連結営業利益	1,700百万円
連結営業利益率	6.5%

■中期重点施策について

- ①高付加価値な商品・サービスへのシフト
- ②重点分野の設定と資源の重点配分による成長の加速
 - ・医療機器関連事業分野
 - ・半導体等関連事業分野
 - ・ニューノーマル（新常態）関連事業分野
 - ・海外展開の強化（中国拠点・北米拠点の機能拡充と強化）
- ③生産性向上に向けたプロセス改革による組織・運用の見直し
- ④M & A・コラボレーション等の推進
- ⑤E S G・S D G s 等に関する体制整備と施策実行

■中期重点施策について

	住生活関連	検査計測 機器	産業機器	エクステリ ア	機械・工具	新規事業 開発
①医療機器関連事 業分野						
②半導体等関連事 業分野						
③新常态（ニュー ノーマル）関連事 業分野						
④海外展開の強化						

検査計測装置事業の 現状および今後について

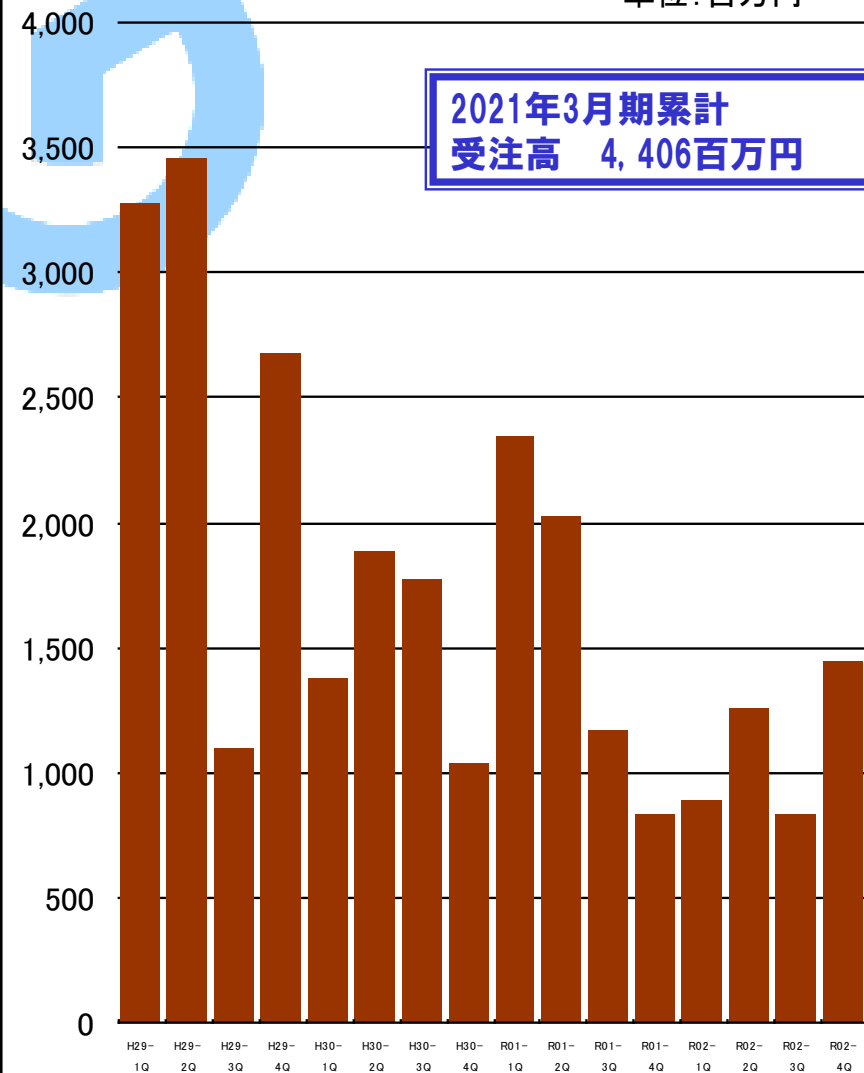
取締役 画像計測部門担当
久留島 馨

1. 当社検査装置の受注状況

四半期受注高推移

単位: 百万円

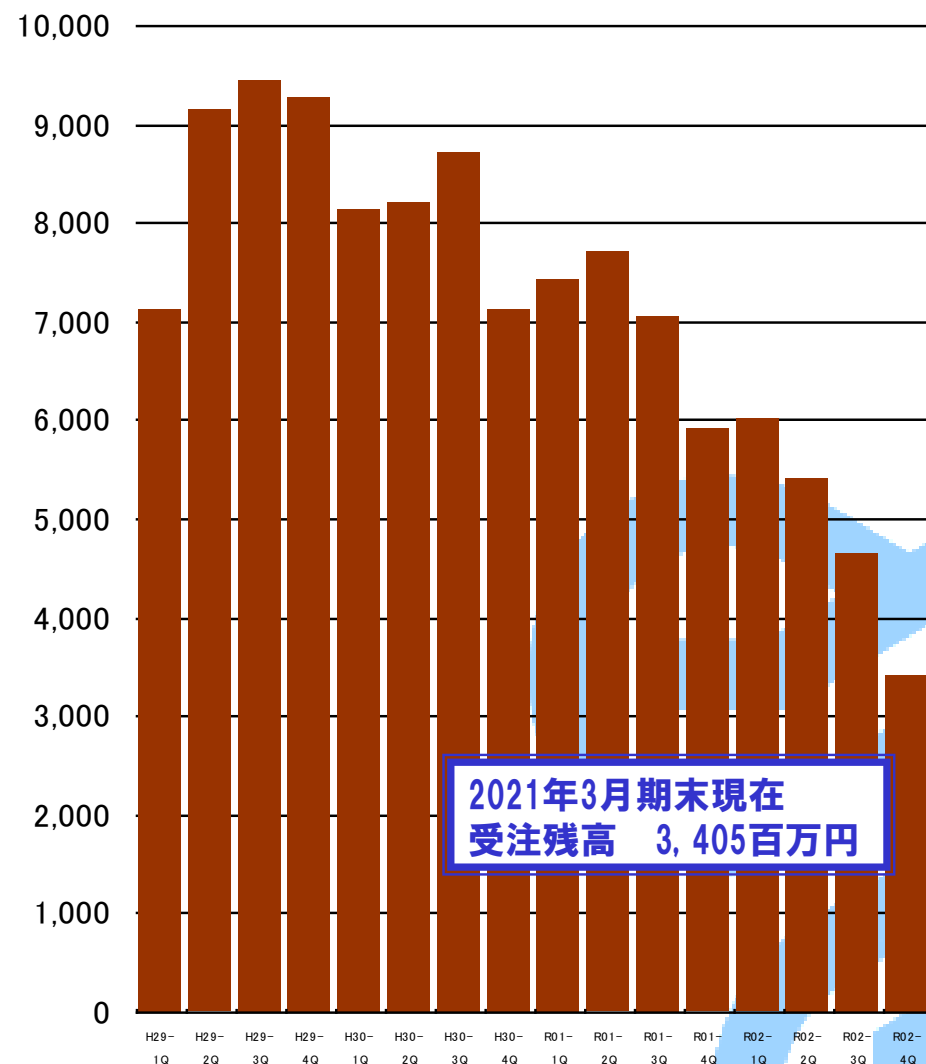
2021年3月期累計
受注高 4,406百万円



四半期受注残高推移

単位: 百万円

2021年3月期末現在
受注残高 3,405百万円



2. 営業ドメインと製品(装置)



AOI for TFT,CF,Cell



簡易MURA Inspection



既設ライン向け

MURA Inspection



開発テーマ
Micro LED
目視検査の自動化
AI(Deep Learning)

AFM



FPD

SEMI

AI

Film

Auto
partsALTAX
(3D)

TSVD



266nm Laser Marker



WMシリーズ



Viシリーズ

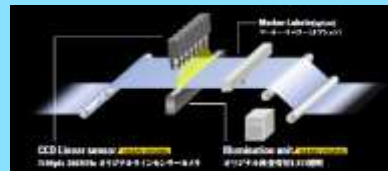
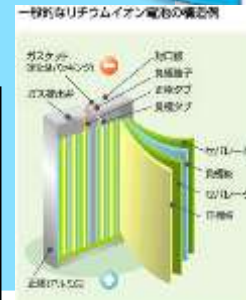


TMEシリーズ



光学Film(偏光板、TAC)

電子材料(MLCC他)

Energy部材
(LIB,FC)

ZEBBRA

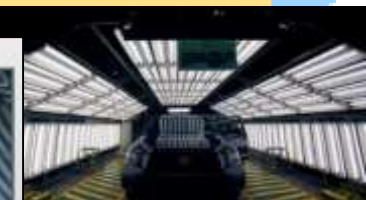
立体構造物の表面欠陥検査装置



デジタルカメラ画像

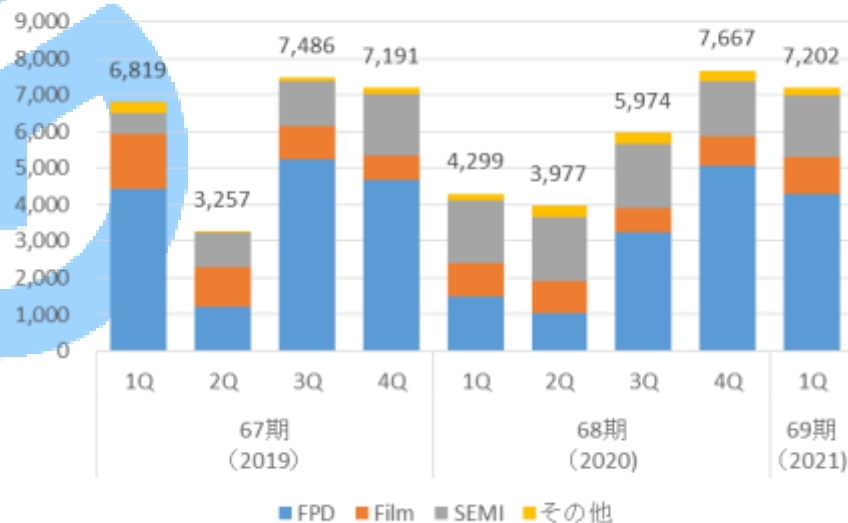


スリット画像



3. 検査計測システム事業の引合状況 単位:百万円

全体引合推移



○ 全体の引合いは例年水準に回復し、増加傾向

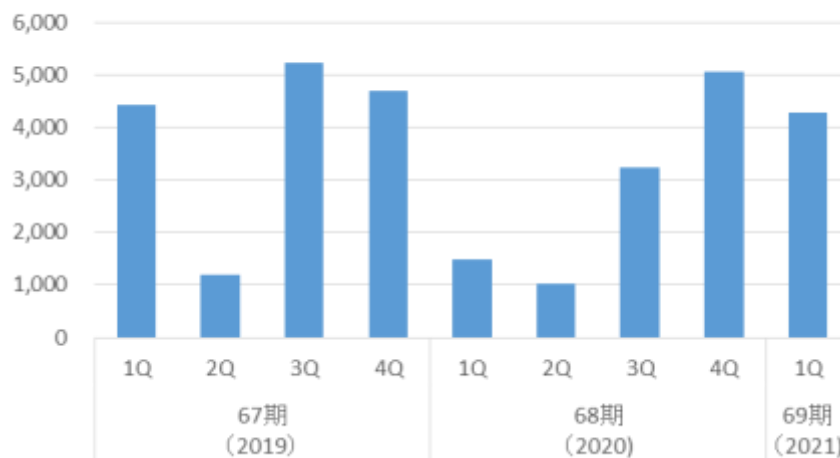
■ FPDは巣ごもり需要で引合い増加傾向

■ SEMI(半導体)WMシリーズがWWで引合い増(KLA中古機の枯渇)

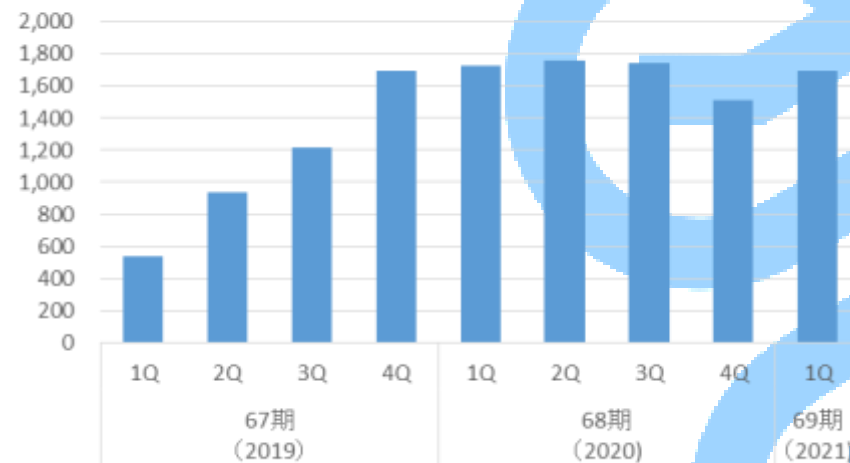
■ SEMI(電子デバイス)SAWフィルター、PKG基板検査機他の引合い増

■ Film関係はMLCC(積層コンデンサ)LIBセパレーター等のエネルギー分野の引合い増

FPD引合推移



SEMI引合推移



4. 半導体市場天気図

半導体

電子部品

	'19/1-6	'19/7-12	'20/1-6	対象機種
DRAM				Vi・WM ALTAX
NAND				Vi・WM
プロセッサ				Vi・WM ALTAX
イメージセンサー				Vi・WM ALTAX
車載用半導体				Vi・WM WLM
光デバイス				Vi・WM
パワーデバイス				Vi・WM WLM
MLCC				
高周波フィルター				Vi・WM WLM
プリント配線基板				ALTAX

注力エリア

5. 半導体システム製品群

1 WM

Non-Pattern surface inspection

- High Throughput
- High CoD
- 100~300mm (50nm~) Application

 **TOPCON**



2 Vi

Pattern Inspection

- Mono & Color Mode
- Pattern Defect Inspection
- Fab Out Inspection
- Wafer Inside Crack Inspection
- Seal Pattern Defect Inspection

 **TOPCON**



3 ALTAX

Hi-Speed Height Inspection

- Bump Height, Coplanarity
- High Throughput
- Au, CPB, WLP Application



4 Depth metrology

TSV/Trench

- High Speed (1 point / sec)
- High A/R (1:10~1:30)
- 1.0 um~ Available



5 AFM

AFM

- Three Dimensional Measurement
- Wide Scanning Range
- Fully Automated Measurement and Analysis



6 Laser

Wafer/Chip Marker

- For Transparent wafers, like SiC/GaN/LN/LT, etc.
- Both Wafer ID and Chip ID marking available.
- Very few contamination and thermal damage.



6. ウェーハ表面検査装置:WMシリーズ

概要

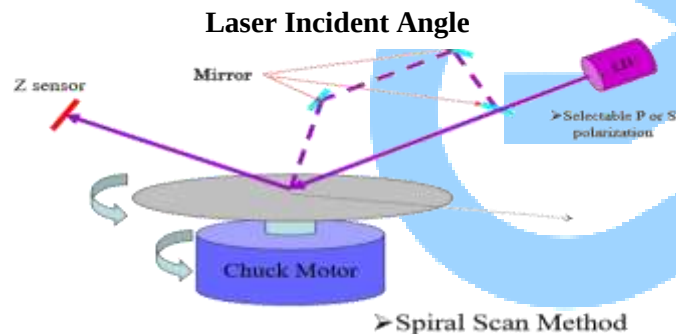
ベアシリコンウェーハ上48nmの高感度でのパーティクル測定が可能です。光源に世界初の青紫色半導体レーザを搭載し48～90nmプロセスノードに最適な性能と圧倒的なコストパフォーマンスを誇る装置です

仕様

検出感度 : 48nm～
光源 : 青紫色半導体レーザ
走査方式 : 螺旋操作方式

用途

Bare-wafer



7. WMマーケットポジション

装置価格

400百万円

300百万円

200百万円

50百万円

ターゲット市場

パワー半導体、車載用半
導体、イメージセンサー

市場規模: 400~500億円

Leading Edge (最先端)

KLA-Tencor



355nm固体レーザー



日立ハイテクノロジーズ
顧客はインテルのみ

市場規模: 50~100億円

KLA中古枯渴



KLA中古



市場成長とともに事業拡大
目標10億円

WM-10

WM-7

405nmLDレーザー



90nm

60nm

30nm

15nm

低い ← 検出感度 → 高い

※この説明資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関する最終決定はみなさまご自身のご判断において行われるようお願いいたします。

※当説明資料で掲載している情報のうち過去の歴史的事実以外のものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、また2021年6月3日現在で入手可能な情報に基づく当社の経営陣の判断に基づいております。従って、将来に関する予想には様々な潜在的リスクや不確定要素が内在されており、実際の業績は種々の要素によりこれらの将来予想とは異なる場合があります。当社はこの資料を使用されたことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。

※従いまして、この資料にある将来に関する予想に全面的に依存して投資等の判断を行うことはお差し控えください。